

**凸版印刷、「第13回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)」に出展**

DX と SX をコンセプトにした展示ブースで、  
最新のデジタル製品・サービスや脱炭素に貢献するサステナブル商材など多数紹介

凸版印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:磨 秀晴、以下 凸版印刷)は、2022年12月7日(水)から9日(金)に開催される「第13回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)」(会場:幕張メッセ)に出展します。

今回、凸版印刷ブース(4ホール 30-60)では、高機能フィルム展と同時開催されるサステナブルマテリアル展の2つの展示会のコンセプトを融合した展示ブースで、自動車、電機、化学から医薬・日用品分野まで、多岐にわたる製造業のお客さまを中心に、最新のデジタル製品・サービスや脱炭素に貢献するサステナブル商材を多数紹介します。



「第13回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)」

凸版印刷ブースイメージ © TOPPAN INC.

**■具体的な出展内容と主な展示ソリューション**

凸版印刷は、今回同時開催される「フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)」と「サステナブルマテリアル展」において、業務課題をサステナブルな視点で解決する DX ソリューションと環境負荷低減に貢献する高機能フィルムを、DX と SX(Digital&Sustainable Transformation)の2つのコンセプトを軸としたコーナーで、社会課題の解決に貢献する製品・ソリューションを紹介します。

**(1) SX(Sustainable Transformation)コーナー:****環境負荷低減に貢献する高機能フィルム・素材**

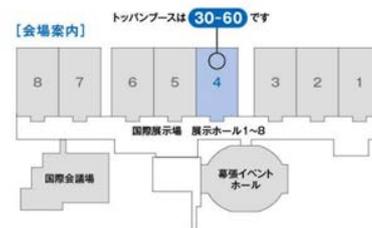
各種の高機能部材やソリューション、脱炭素に貢献する最先端のサステナブルパッケージを、業界や用途別に紹介します。環境負荷低減に貢献する、透明バリアフィルム、加飾フィルム、紙製バリア容器、エネルギー部材など、皆様の課題解決のヒントとなる、トッパンの最新の開発製品・サービスを紹介します。

**(2) DX(Digital Transformation)コーナー****業務課題をサステナブルな視点で解決する DX ソリューション**

製造現場の省力化・高度化などの業務改善を実現するデジタルピッキングなどの各種システムや、RFID・コード活用による製品の真贋判定・トレーサビリティ技術などを中心に紹介します。デジタルピッキングシステム、部品生産システム、IoT パッケージング、真贋ラベルソリューションなどの展示により、トッパンの DX ソリューションを体感頂ける構成となっています。

## ■展示会概要

名称： 第13回 フィルムテック ジャパン(高機能フィルム展)  
会期： 12月7日(水)～9日(金) 10:00～18:00(最終日のみ 17:00 終了)  
会場： 幕張メッセ (凸版印刷ブース:4ホール 30-60)  
主催： RX Japan 株式会社 (旧社名: リード エグジビション ジャパン)



概要： 機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に周転する世界最大規模の展示会です。また、材料だけではなく、材料の製造加工機械、検査測定分析機器など素材産業に関わるあらゆる技術が出展しています。各業界の研究・開発・設計・製造担当者が来場し、出展社と活発な商談が行えます。

展示会 URL: [www.material-expo.jp/film/](http://www.material-expo.jp/film/)

- \* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
- \* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上